



納入仕様書

Specification of Crystal Unit

XRCMD32M000FXP50R0

決定年月日 February 9, 2015
Date

1. 適用 Scope

当納入仕様書は、通信機器及び民生機器に使用する水晶振動子について規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the crystal unit used for the mobile and consumer equipments. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

2. 品番 及び 貴社関連事項 Part Number

- 2-1 当社品番 : XRCMD32M000FXP50R0
Murata Part Number
- 2-2 貴社部品番号 :
Customer's Part Number
- 2-3 貴社仕様書番号 :
Customer's Drawing Number

3. 定格 Rating

	項目 Item	規格 Specification
3-1	動作温度範囲 Operating Temperature Range	-30 to +85°C
3-2	保存温度範囲 Storage Temperature Range	-40 to +85°C
3-3	励振レベル Drive Level	30 μ W (100 μ W max.)
3-4	負荷容量 (Cs) Load Capacitance	6.0pF
3-5	オーバートーン次数 Overtone Order	基本波 Fundamental

株式会社 村田製作所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

掲載されている仕様については、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
This information may be changed without a previous notice.

4. 電气的性能 Electrical Characteristics

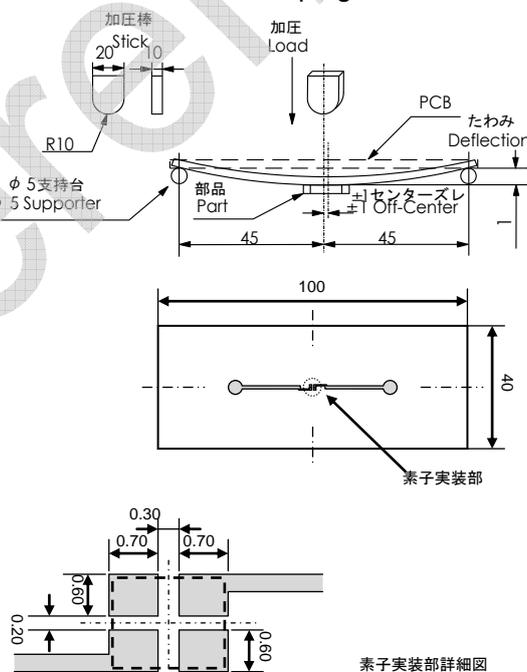
	項目 Item	規格 Specification
4-1	公称周波数 Nominal Frequency	32.0000MHz
4-2	総合周波数偏差 (以下の項目を含む) Total Frequency Tolerance (including the following items) ・周波数許容偏差 (+25°C) *1 Frequency Tolerance (+25°C) *1 ・周波数温度依存性 (-30 to +85°C) *1 (+25°Cの値に対して) Frequency Shift by Temperature (-30 to +85°C) *1 (from initial value at +25°C) ・周波数エージング (+25°C、1year(s)) *1 (初期値に対して) Frequency aging (+25°C、1year(s)) *1 (from initial value) ・リフロー後の周波数変動量 (2time(s)) *1 *2 (初期値に対して) Frequency deviation after reflow-soldering (2time(s)) *1 *2 (from initial value)	±30ppm 以内/max.
4-3	等価直列抵抗 (ESR) *1 Equivalent Series Resistance (ESR) *1	100Ω 以下/max.
4-4	絶縁抵抗 *3 Insulation Resistance *3	500MΩ 以上/min. (D.C.100±15V 印加時) (Applied D.C. 100±15V)

*1 周波数および等価直列抵抗の測定方法は7項を参照ください。
Please refer to item 7 for measuring method of frequency and Equivalent Series Resistance.

*2 リフロープロファイルは10項を参照ください。
Please refer to item 10 for the recommendable soldering profile.

*3 端子相互間での抵抗を示します。
This characteristic shows the resistance between terminals.

5. 機械的性能 Physical Characteristics

	項目 Item	試験条件 Test Condition	試験後の規格 Specification After Test
5-1	自然落下 Free Fall	製品を模擬治具（荷重負荷120g）に取り付けた状態で、1.5mの高さからコンクリートに6方向各10回自然落下させた後測定します。 Components shall be measured after drops in 6 perpendicular directions, total 60 times, with 120g dummy housing onto a concrete floor from a height of 1.5m.	外観に異常がなく、表1を満足します。 No visible damage and the measured values shall meet Table 1.
5-2	正弦波振動 Vibration (sinusoidal)	製品を実装基板に実装した状態で、振動周波数10~55Hz、全振幅1.5mmの振動をX,Y,Zの3方向に各2時間加えた後測定します。 Components shall be soldered on PCB, and applying the vibration of amplitude 1.5mm and vibration frequency 10 to 55Hz in each of 3 perpendicular directions for 2 hours.	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.
5-3	基板たわみ Substrate Bending	<p>下図に示すたわみ試験用基板に実装し、矢印の方向に1回たわませます。 たわみ量: 1mm 保持時間: 10秒 After components soldered on the test board PCB, the load shall be applied to the PCB in the direction of the arrow for 1 time. Deflection: 1mm Keeping time: 10s</p>  <p>基板厚み / PCB thickness : 0.8mm 単位 / unit : mm</p>	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.

5-4	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat (1)リフロー方式 (1)Re-flow Soldering	製品単品状態でリフロー炉（ピーク温度260℃、10秒、その他条件は10-6-2項を参照）に2回通した後、室温に取り出し24時間後測定します。 Components shall be measured after applying twice of the re-flow soldering (peak temperature 260°C, 10s, and refer to item 10-6-2 for other condition) and leaving in room condition for 24 hours.	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.
	(2)コテ付け方式 (2)Soldering with iron	PCB上にて温度+350±5℃で5.0±0.5秒間はんだ付けを行い、室温に24時間放置後に測定します。但し、はんだこて先は電極部に直接接触しない事とします。 Components shall be measured after being soldered on PCB with a soldering iron of +350±5°C for 5.0±0.5 seconds and left in room condition for 24 hours. The soldering iron shall not touch the components while soldering.	外観に異常がなく、表1を満足します。 No visible damage and the measured values shall meet Table 1.
5-5	はんだ付け性 Solderability	PCT装置にて温度+105℃、湿度100%R.H.の条件で、4時間のエージングをした後、端子部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、+245±5℃の溶融はんだ(Sn-3.0Ag-0.5Cu)中に5±0.5秒間浸します。 After being kept in a pressure cooker chamber of +105°C, 100%R.H. for 4hours, terminals of components shall be placed in a rosin-methanol for 5 seconds and then immersed in a soldering bath(Sn-3.0Ag-0.5Cu) of +245±5°C for 5±0.5 seconds.	端子の90%以上にははんだが付着します。 Ninety(90)% or more of terminal surface shall be coated with solder.

6. 耐候性能 Environmental Characteristics

	項目 Item	試験条件 Test Condition	試験後の規格 Specification After Test
6-1	高温放置 Dry Heat (Storage)	製品を実装基板に実装した状態で、温度+85±2℃の恒温槽中に1000時間保持し、室温に取出して、24時間後に測定します。 Components shall be soldered on PCB, and be left in a chamber (Temperature: +85±2℃) for 1000 hours, then measured after leaving in room condition for 24 hours.	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.
6-2	低温放置 Cold (Storage)	製品を実装基板に実装した状態で、温度-40±2℃の恒温槽中に1000時間保持し、室温に取出し24時間放置後に測定します。 Components shall be soldered on PCB, and be left in a chamber (Temperature: -40±2℃) for 1000 hours, then measured after leaving in room condition for 24 hours.	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.
6-3	高温高湿放置 Humidity	製品を実装基板に実装した状態で、温度+60±2℃湿度90～95%R.H.の恒温恒湿槽中にて1000時間保持した後、室温に取り出して24時間後に測定します。 Components shall be soldered on PCB, and be left in a chamber (90 to 95%R.H. at +60±2℃) 1000 hours, then measured after leaving in room condition for 24 hours.	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.
6-4	熱衝撃 Thermal Shock	製品を実装基板に実装した状態で、温度-40℃の恒温槽中に30分間保持後、温度+85℃の恒温槽中に直ちに移動し、30分間保持する。これを1サイクルとし、全10サイクル行い、室温に取り出して24時間後に測定します。 Components shall be soldered on PCB, and after performing 10 cycles of thermal test (-40℃ 30 minutes to +85℃ 30 minutes), components shall be left in room condition for 24 hours.	表1を満足します。 The measured values shall meet Table 1.

表1 Table 1.

周波数変動量 Frequency deviation	±3ppm 以内/max. (初期値に対して/from initial value)
ESR変動量 ESR deviation	±5Ω 以内/max. or ±30% 以内/max. (初期値に対して/from initial value)

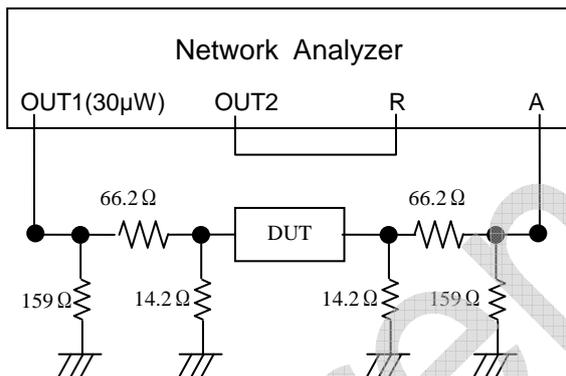
7. 測定方法 Measuring Method

7-1 周波数測定方法

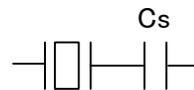
: 4、5、6項で示す周波数は、第1-1図で示す回路とネットワークアナライザ(Agilent E5100Aもしくは相当品)にて測定した負荷時共振周波数(共振点近傍において、電気的インピーダンスが抵抗性となる2つの周波数のうち、低い方の周波数)を示します。DUTは第1-2図に示します。負荷容量値(Cs)は3-4項を参照ください。負荷時共振周波数の規格値は、励振レベル: 30 μWで測定した値です。

Frequency measuring method: Frequency mentioned in the items of 4, 5, 6 means the load resonance frequency(Lower frequency of the two given when the electrical impedance of the component becomes resistant near its resonance point) measured by network analyzer (Agilent E5100A or the equivalent) and the circuit in Figure.1-1. DUT is shown in Figure 1-2, and the value of a load capacitor (Cs) is referred to the item of 3-4.

The load resonance frequency is measured at drive level of 30 μW.



第1-1図 周波数測定回路
Figure 1-1 Frequency measuring circuit

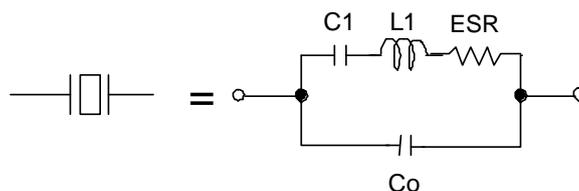


第1-2図 DUT(被測定デバイス)
Figure 1-2 DUT (Device Under Test)

7-2 等価直列抵抗

: 4項に示す等価直列抵抗(ESR)は、第1-1図で示す回路とネットワークアナライザ(Agilent E5100Aもしくは相当品)にて測定します。DUTは第1-3図に示します。

Equivalent series resistance : The equivalent series resistance (ESR) which mentioned in item 4 is measured by network analyzer (Agilent E5100A or equivalent) and the circuit in Figure.1-1. DUT is shown in Figure 1-3.



第1-3図 DUT (被測定デバイス)
Figure 1-3 DUT (Device Under Test)

- 7-3 測定条件 : 温度 $+25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、湿度45~85%R.H.を標準測定状態とします。
Measuring Condition : Standard conditions for the measurement shall be $+25\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperature and the humidity of 45 to 85%R.H. .

8. テーピング品包装規格 Packaging Standard (Taping)

- 8-1 テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる向き)とします。
The tape for components shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user.
- 8-2 チップは、1リール 3,000個収納します。
A reel shall contain 3,000pcs of components.
- 8-3 プラスチックテープの外形寸法図を第3図に示します。
Dimensions of plastic tape are shown in Figure 3.
- 8-4 プラスチックリールの外形寸法図を第4図に示します。
Dimensions of plastic reel are shown in Figure 4.

9. ⚠注意 Cautions

9-1 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。ただし、⑥の輸送機器は、機器の動作に直接かかわる用途でのご使用は避けてください。(具体例:エンジン制御、ブレーキ制御、ステアリング制御、ボディ制御)

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器
⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通信号機器 ⑧防災/防犯機器
⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

Notice, please do not use this products in following applications in transportation equipment. (example: engine control, brake control, steering control, body control.)

- ①Aircraft equipment
②Aerospace equipment
③Undersea equipment
④Power plant control equipment
⑤Medical equipment
⑥Transportation equipment(vehicles, trains, ships, etc.)
⑦Traffic signal equipment
⑧Disaster prevention / crime prevention equipment
⑨Data-processing equipment
⑩Applications of similar complexity and/or with reliability requirements to the applications listed in the above

9-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

10. 使用上の注意 Caution for Use**10-1**

過大な機械衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご注意ください。

The component may be damaged if excess mechanical stress is applied.

10-2

ご使用条件により、発振不具合（異常発振あるいは発振停止）が発生する場合がありますので、回路条件を充分ご確認ください。

Please confirm the circuit conditions on your set, because irregular or stop oscillation may occur under unmatched circuit conditions.

10-3

当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。但し、実装条件によっては過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で必ず評価確認をして下さい。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けて下さい。詳細については事前に当社までお問い合わせ下さい。

The component is recommended with placement machines employing optical placement capabilities. The component might be damaged by mechanical force depending on placement machine and condition. Make sure that you have evaluated by using placement machines before going into mass production. Do not use placement machines employing mechanical positioning. Please contact Murata for details beforehand.

10-4

実装後に基板から取り外した製品は再使用しないで下さい。

Do not reuse components once mounted onto a circuit board.

10-5

調査または分析が必要な場合は、基板から製品を取り外すときに過剰な熱が加わらないよう注意して下さい。

In case of investigation or analysis is needed, please take care when removing the crystals from circuit board. (Please do not over heat)

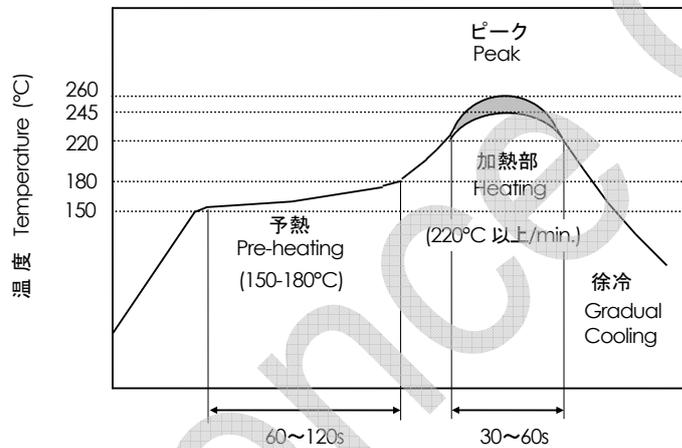
10-6 はんだ付けに関する注意事項 Caution for Soldering

この製品はリフロー方式で実装をお願いします。
Please mount components on a circuit board by the re-flow soldering

10-6-1 推奨するフラックスおよびはんだ Recommendable Flux and Solder

フラックス Flux	ロジン系フラックスをお使いください。水溶性フラックスは使用しないでください。 Please use rosin based flux, but do not use water soluble flux.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu組成のはんだをご使用ください。 クリームはんだ塗布厚は、0.10~0.15mmの範囲でお願いします。 Please use solder(Sn-3.0Ag-0.5Cu) under the following condition. Standard thickness of soldering paste : 0.10 to 0.15mm

10-6-2 推奨はんだ条件 Recommendable Soldering Profile



標準プロファイル Standard soldering profile	
予熱 Pre-heating	150°C to 180°C 60s to 120s
加熱部 Heating	220°C 以上/min. 30s to 60s
ピーク温度 Peak temperature	245°C以上/min. 260°C以下/max. 5s 以内/max.
注意事項 Caution	明記したリフロー温度を保ってください。 (260°Cを超える温度を加えないで下さい) Please keep the temperature of the re-flow soldering as specified. (Please do not add temperature of more than 260°C)

*温度は部品表面付近で測定します。

*Temperature shall be measured on the surface of component.

10-6-3 こて付け条件 Reworking with soldering iron

やむを得ずはんだこてを使用して製品をはんだ付け・修正する場合は、以下の点に注意して行って下さい。

Please solder with soldering iron noting to the following conditions.

	条 件 condition
予熱温度 Pre-heating	150°C 60s
はんだこてのこて先温度 Heating of the soldering iron	350°C 以下/max.
はんだこてのワット数 Watt	30W 以下/max.
はんだこてのこて先形状 Shape of the soldering iron	φ 3mm 以下/max.
はんだ付け時間 Soldering Time	5s 以内/max.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu
注意事項 Caution	<p>製品に直接こて先がふれないようにして下さい。こて先が製品に直接触れて過剰な熱が加わった場合、製品電極の破損につながる恐れがあります。</p> <p>金属キャップ部にはんだが付着しないようにして下さい。</p> <p>Please do not directly touch the components with soldering iron, because the terminals of components may be damaged if excess thermal stress is applied.</p> <p>Please keep solder off from the metal cap (Lid) portion.</p>

11. 製品保管上の注意 Notice on product storage**11-1**

温度-10～+40℃、相対湿度15～85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。

Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions : Temperature : -10 to +40 °C

Humidity : 15 to 85% R.H.

11-2

製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。

Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.

If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

11-3

酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.

11-4

湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。

Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.

11-5

直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in the places under direct sunlight, heat and vibration.

11-6

開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。

Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.

11-7

製品落下により、製品内部の水晶素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。

Please do not drop the products to avoid cracking of crystal element.

12.  お願い Note:

12-1

ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。

Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

12-2

当製品を当納入仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。

You are requested not to use our product deviating from this product specification.

12-3

お手数ですが、当納入仕様書に貴社受領印を押印の上、1部を弊社へご返却下さい。

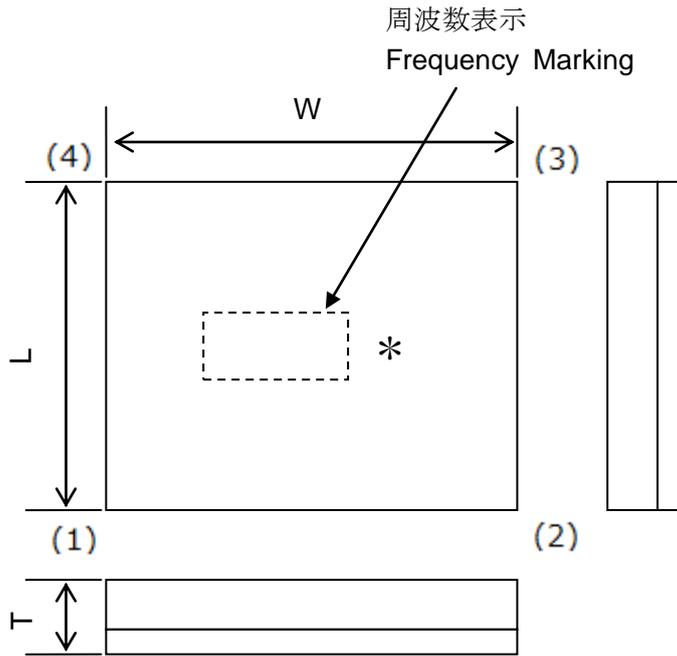
3ヶ月以内にご返却いただけない場合、又は、当納入仕様書をご返却いただく前にご注文をいただいた場合は、当納入仕様書は、その時点で受領されたものとさせていただきます。

Please return one duplicate of this product specification to us with your signature to acknowledge your receipt. In case of no return within three months from submission date, or if we receive order before the duplicate is returned, this product specification will be deemed to have been received by you.

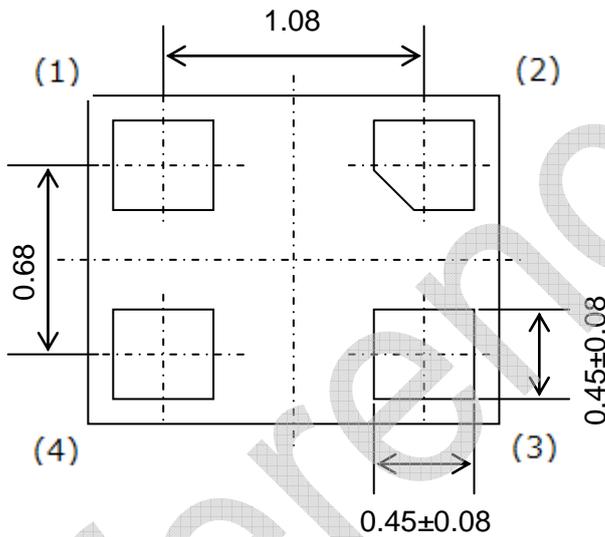
12-4

弊社は、仕様書、図面その他の技術資料には、取引に関する契約事項を記載することは適切ではないものと存じております。従って、もし、貴社が作成されたこれら技術資料に、品質保証、P L、工業所有権等にかかる弊社の責任の範囲に関する記載がある場合は、当該記載は無効とさせていただきます。これらの事項につきましては、別途取引基本契約書等においてお申し越しいただきたくお願いします。

We consider it not appropriate to include any terms and conditions with regard to the business transaction in the product specifications, drawings or other technical documents. Therefore, if your technical documents as above include such terms and conditions such as warranty clause, product liability clause, or intellectual property infringement liability clause, they will be deemed to be invalid.



W : 1.6 ± 0.1
L : 1.2 ± 0.1
T : 0.33 max.



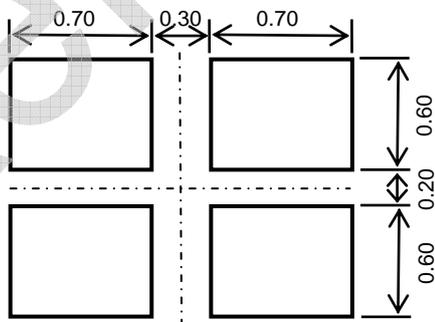
周波数表示
Frequency Marking : U

*
単位
Unit

端子番号
Terminal Number

製造年月日
: EIAJ Monthly Code
mm
(1) 入出力
Crystal terminal
(2) ノーコネク
No connect
(3) 入出力
Crystal terminal
(4) GND電極
GND

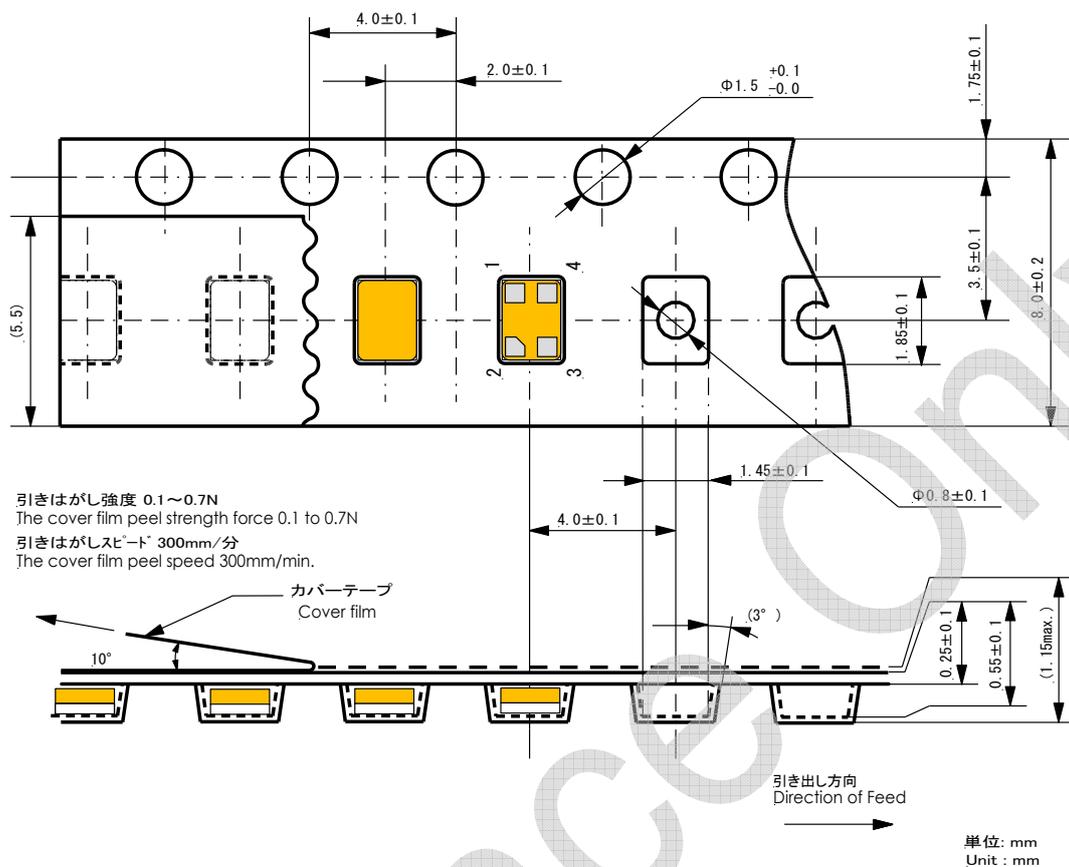
(推奨ランド寸法)
(Recommendable Land Pattern)



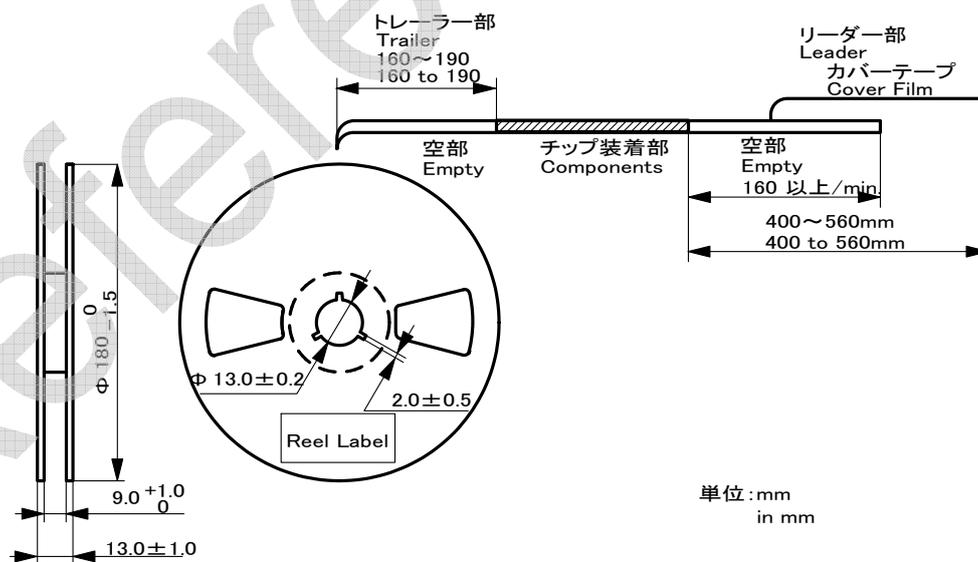
第2図 外形寸法図
Figure 2. Dimensions

株式会社 村田製作所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

掲載されている仕様については、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
This information may be changed without a previous notice.



第3図 プラスチックテープの外形寸法図
Figure 3. Dimensions of Plastic Tape



第4図 プラスチックリールの外形寸法図
Figure 4. Dimensions of Plastic Reel